

DKN・ニュースレター

#0623、2006年6月4日

今週の話題

先週5月31日から3日間、東京ビッグサイトにおいて恒例のJPCAショー2006が開催されました。今年は昨年にも増して来場者が多かったようで、最終日の午後などは会場内での移動もままならないくらいの混雑ぶりでした。海外からの来場者も多く、韓国、台湾、中国はもとより、タイやシンガポール、さらにはどの国から来たのかわからないような人々も数多くみられました。欧米からの来訪者は相変わらず少なかったようですが、それでも昨年に比べるといくらか多くなっているような印象を受けました。今年からの新しい試みとして、展示会場で、オープンセミナーが組織的に開かれたことです。各セッションの会場には100席近い椅子が用意されていたのですが、いずれも満員の盛況で、立ち見で聴講する人々の壁ができました。このように、来場者が増え、活発な情報公開がおこなわれるということは、世界のプリント基板産業の状況がいくらかでも好転してきている表れでしょうか。

今年のJPCAショーでは画期的な技術や新しいビジネスの動きはなく、一言でその特徴を表す適当な言葉がちょっとみつかりません。それでも、個々の技術やビジネスでは、この1年間にそれなりの進展があり、いろいろと学ぶところが少なくありませんでした。強いてキーワードを挙げると超高密度回路、フレキシブル基板、ICサブストレート、LDI、RoHS、アジアメーカーの進出といったところでしょうか。

その他、表に出ないところで、プリント基板技術の経験者の情報の交換が多く行われていました。特に中国あたりの新興メーカーから、高密度回路やフレキシブル基板の製造経験者を探し求める話が、少なからず聞こえてきました。ここでは、完全に需給バランスがくずれており、経験豊かで、能力のあるエンジニアはひっぱりだこのようです。もっとも、採用する方も、採用される方も、当初の思惑とは違っていることも少なくなく、短期間で破綻している例も多いようです。

一方で、事業の縮小や閉鎖をするケースも少なからずあるようで、ショーの会場では中古設備の処分に関する情報もかなり飛び交っていました。オークション会社などが公開で販売する一方で、少しでも良い値段で処分したい会社と、まとまった設備を手頃な値段で入手したい会社が、あちこちで交渉しているのが見かけられました。

来週からしばらく、ショーの主なトピックスをもう少し掘り下げてみたいと思います。

沼倉研史
DKNリサーチ

今週のヘッドライン 2006年6月4日

1. **ヤシン(台湾のプリント基板、EMSメーカー大手) 5 / 29**
液晶のバックライト用に、BIP (Build - in - chip Package) 技術を適用した、廉価なLEDモジュールを発表。
2. **ジェイビルサーキット(米国のEMS大手) 5 / 29**
企業イメージを一新のために、新しいロゴを採用。サーキットメーカー以上のイメージを入れる。
3. **インヴェンテック(台湾のPCメーカー) 5 / 29**
2006年に東芝向けのノートブックPCは、前年比で3倍増の30万台に。東芝のトップサプライヤーに。
4. **フォックスコン(台湾のEMS最大手) 5 / 29**
生産効率向上のため、ハンガリー南部の Pecs 工場を、3ヶ月以内に閉鎖し、北部の Komarom 工場へ統合へ。
5. **ZVEI (ドイツの基板産業団体) 5 / 29**
4月のドイツプリント基板産業のB / Bレシオは0.99に下落。
6. **ホンハイ(台湾のEMS最大手) 5 / 30**
ファイナンスの改善のために、180億台湾ドルの転換社債を発行へ。
7. **イノヴェックス(米国のフレキシブル基板大手) 5 / 30**
2006年第3四半期(～6月30日)の売上げ予測を、需要の下落にともない、当初の4400～4600万ドルから3800～4000万ドルに下方修正。
8. **インドの電話回線 5 / 29**
インドの電話回線は、現在の7千万から、2007年末までに2億5千万に増加の見込み。ノキア社はチェンナイの携帯電話工場に1億5千万ドルを投資の計画。
9. **ASAT(香港の半導体パッケージ大手) 5 / 30**
中国本土の東莞に、床面積56万平方フィートの新しい工場を開設。操業を開始。
10. **Haier Group (中国のエレクトロニクス企業大手) 5 / 30**
タイでIT関連製品や液晶テレビの生産を行うために、現地企業と合併会社を設立へ。

11. ヴィステオン(米国の自動車部品メーカー) 5 / 30

ヨーロッパの自動車メーカーをターゲットに、スロバキアでの電子機器製品の生産能力を強化へ。

12. IPC(米国) 5 / 30

4月の北米プリント基板産業のB / Bレシオは0.06ポイント下がって1.07に。硬質基板、フレキシブル基板とも下落。フレキシブル基板は昨年4月以来の最低を記録。出荷インデックスも低いレベル。

13. Mフレックス(米国のフレキシブル基板大手) 5 / 30

モトローラ社の携帯電話向けフレキシブル基板の需要が減退するとのうわさが否定され、株価は急騰。

14. サーキットロニクス(米国の基板メーカー) 5 / 30

EPAから、イリノイ州の工場での廃液の違法排出を摘発され、21,362ドルの罰金支払い。

15. EoPlex (米国のベンチャー企業) 5 / 31

工業用のプリンターで機械的な微小部品を形成する新しい技術を開発。

16. ルーヴェル(ドイツの基板メーカー大手) 5 / 31

ルーマニアのテタロムで、8千万ユーロを投資して、新しいプリント基板工場を建設へ。600名を新たに雇用する計画。

17. クックソン(英国の基板用化学品メーカー) 5 / 31

中国での事業を強化するために、蘇州などの製造拠点で1千万ポンドの設備投資。

18. BASF(ドイツの化学会社大手) 6 / 1

中国の上海地区にエレクトロニクス用化学品の工場を建設へ。当初の従業員として、33名を雇用の予定。

19. エクセロン(NCドリル装置メーカー大手) 6 / 1

カリフォルニアの Rancho Dominguez に新たにスピンドル修理センターを開設。

20. オービット・ワン(スウェーデンのEMS) 6 / 2

ロシアの市場をターゲットに、カーニングラードに電子機器の組立工場を建設へ。スウェーデンの工場の業務の移管は予定していない。

21. ZVEI (ドイツの基板業界団体) 6 / 2

2005年の世界プリント基板生産額は、前年比で6%増の385億米ドルに達したと推定。

2.2.ボーイング(米国の航空機メーカー) 6 / 1

米国のNASAと協力して、過酷な環境で使用可能な電子回路基板を開発へ。

(注)このヘッドライン・ニュース・レターは速報性を重視するために、若干の誤訳や数字の変換に誤りがある場合もございます。ご了承下さい。

DKNリサーチ
栄泰産業株式会社

最近の興味深い文献から

Articles of DKN Research

1. “Digest Version of the 2006 Global Projection for Flex Circuit” DKN Research, March 2006. <http://www.dknresearch.com/GPFC2006.html>
2. 「よくわかるICパッケージのできるまで」沼倉研史 & J. ヴァーダマン、日刊工業新聞社、2005年12月発行、1800円
“Easy understanding Series, How to make IC packages”, (Japanese only), Jan Vardaman & Dominique Numakura, Nikkan Kogyo Shinbun, December, 2005, 1800 yens.
3. 「先端実装インサイド、No. 12 . 高密度実装への道(4)新しいICパッケージ」沼倉研史、実装技術、2006年2月号
“The latest semiconductor package, Part IV”, Dominique Numakura, Electronics Packaging Technology, February, 2006
4. 「高密度フレキシブル基板の最新技術動向」沼倉研史、電子材料7月号別冊、実装技術ガイドブック、2005
“The Latest Technology Trends of the High Density Electronic Circuits”, Dominique Numakura, Denshi Zairyō, the Special Edition of Jisso Guidebook, July, 2005
5. “Technical Roadmap of High Density Interconnects with Flexible Substrates in Portable Electronics”, Robert Turunen & Dominique Numakura, PCB Design Conference West, Mar. 10, 2005, Santa Clara

From the Major Industry Magazines

1. “Made in Europe”, Pete Starkey, CircuiTree, May, 2006.

2. "Running Pb-Free Reflow Profiles without Nitrogen", Eli Westerlaken, Circuits Assembly, May, 2006.
3. "AOI: A Strategy for Closing the Loop", Peter Conlon, SMT, May. 2006
4. "Nano Technology and PCBs (Could nano PCB miniaturization allow the IC world to finally merge with SMT?)" Michael Shores, Printed Circuit Design & Manufacturing, March, 2006.
5. "Socket Technology Validates High-frequency Devices", James Rathburn, Advanced Packaging, April, 2006
6. "Acid-Based Machining Dissolves Part-Making Problems", William Leventon, MD&DI, February, 2006